

Electronic Journal 第1067回 Technical Seminar

タッチパネルの貼り合わせ技術 徹底解説**～ 打ち抜きから貼り付け・貼り合わせの極意を詳解～**

主催：電子ジャーナル

日時：1月16日（月）13:00～16:50

講師：(株)FUK 開発部 設計課 佐伯和幸氏

会場：総評会館

定員：30名 定員になり次第、締め切らせて頂きます。お早めにお申込み下さい。

スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器では、コモディティ化を避けるため、各メーカーは様々な技術で、高精細で薄型かつ耐久性に優れた新製品を投入して競い合っています。そのような美しく薄くて強い製品を実現するためには、信頼性と光学特性に優れた接合材料と高度な貼り付け・貼り合わせ技術が求められます。本セミナーでは、前面カバー、タッチセンサやLCDモジュールなど、貼り付けに関するコア技術から、タッチパネル製造に関するプロセス動向と最新技術を動画を交えて紹介します。また、FUKが展開する数値制御によるプロセスコントロールを導入した貼り付け技術において、従来エアードライブでは困難であった貼り付けプロファイルの数値化を実現し、さらにカバープラスチックを多面付け可能な高浸透打抜き装置をラインナップに加え、打ち抜きから貼り付け・貼り合わせまでの「One Stop Solution」を提案しており、これらの内容についても分かりやすく、かつ詳細に解説します。

《プログラム》

- 【13:00～14:00】 タッチパネル製造工程
打ち抜きに求められるもの
- 【14:00～15:00】 打ち抜きプロセス
貼り付け・貼り合わせに求められるもの
1. 接合材料（OCA・OCR）への要求
2. 部材（ガラス・フィルム）への要求
3. （3）プロセス（装置）への要求
- 【15:10～16:40】 貼り付け・貼り合わせプロセス
1. Soft to Soft / Soft to Hard
2. Hard to Hard
装置の紹介
その他のディスプレイ
貼り付け・貼り合わせの技術トレンド
- 【16:40～16:50】 名刺交換会